

JAPAN
SEMICONDUCTOR

ジャパン半導体株式ファンド

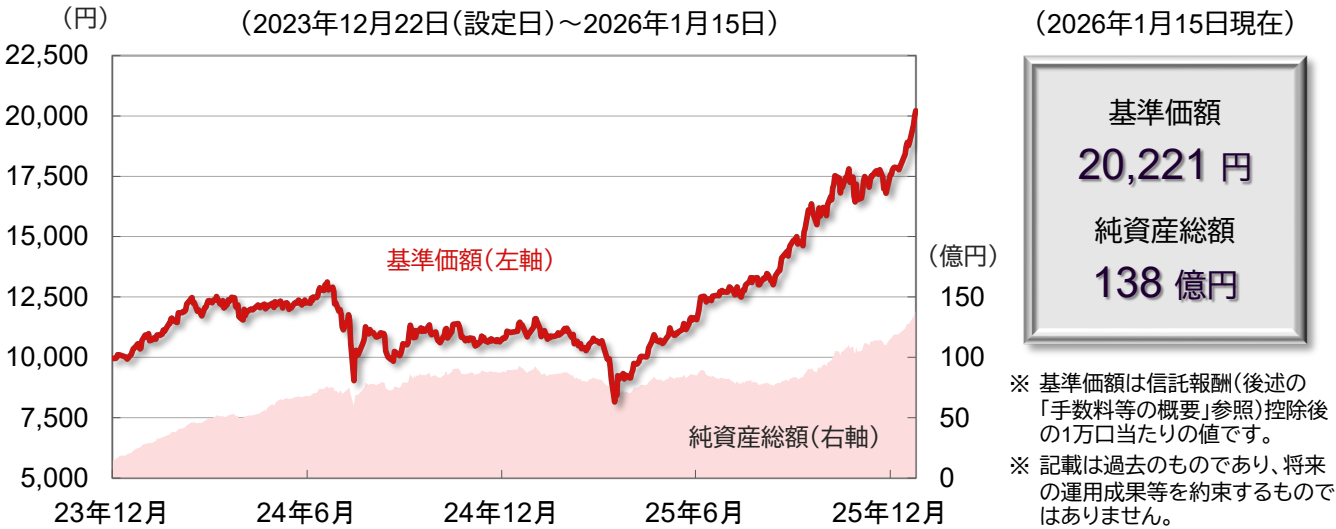
運用者に聞く！ファンドの投資環境や今後の注目点など

当ファンドは日本の半導体関連企業の株式を主要投資対象とします。本資料では、パフォーマンスの状況や半導体市場の成長見通し、今後の成長ドライバーなどについて、当ファンドのマザーファンドの運用者からのコメントをご紹介します。

本資料の
内容

- ✓ 設定来のパフォーマンスと局面ごとの状況
- ✓ 半導体市場の成長見通しと想定されるリスク
- ✓ 今後の半導体業界を牽引する成長ドライバー
- ✓ 日本政府の動向と半導体産業への影響について
- ✓ 運用者の注目点と対中動向に対する見方
- ✓ 組入上位銘柄のご紹介

基準価額と純資産総額の推移



本資料はマザーファンドの運用担当者のコメントをもとに作成しています。本資料は、資料作成時点における市場環境について、運用担当者の見方あるいは考え方等を記載したものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。また、見解は変更される場合があります。

日本株式は2025年4月以降、堅調を維持、 なかでも半導体関連銘柄は力強い上昇を遂げる

当ファンドの設定以降、日本株式は上昇基調となったものの、24年夏の急落後は上値の重い展開となり、25年4月には再び大きく下落しました。しかし、その後は堅調を維持し、主要株価指数が相次いで最高値を更新するなど、大きく上昇しました。

＜当ファンドの基準価額と主要株価指数の推移および期間別騰落率＞
(2023年12月21日(設定前日)～2026年1月15日)



期間 A

(24年7月11日～25年4月7日)

- 24年7月から9月にかけて、米中対立の激化懸念に加え、日銀の利上げ観測を受けた円高進行、米国の景気不安などが嫌気されて荒れた相場展開に
- 25年に入ると、米トランプ政権の関税政策を巡る不透明感や米景気減速懸念などから投資家のリスク回避姿勢が一段と強まる

期間 B

(25年4月7日～26年1月15日)

- 米中摩擦を巡る過度な懸念が後退したほか、米利下げ観測などから市場心理が改善
- 日米企業の堅調な決算発表や円安の進行、新政権の財政拡張期待などが相場を押し上げる
- **AI(人工知能)市場への成長期待**から、日本でも**半導体関連銘柄が株式市場の牽引役**となる

-38%

-25%

-20%

148%

75%

62%

■ 当ファンド ■ 日経平均株価(税引後配当込み) ■ TOPIX(東証株価指数, 税引後配当込み)

※ 基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の値です。

※ 指数は当ファンドのベンチマークではありません。

信頼できると判断したデータをもとにアモヴァ・アセットマネジメントが作成

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

AI投資の拡大や自動運転技術の進展などを追い風に、強弱を伴いながらも半導体市場は拡大する見込み

2026年は引き続き、巨大テック企業をはじめとする**AI投資の拡大が半導体需要を牽引**すると考えています。加えて、自動運転技術の進展などを背景に、足元で低調な車載向け半導体についても需要の拡大が期待されます。

一方、短期的なリスクとして、半導体メモリ価格の高騰により、PCやスマートフォン(スマホ)などの最終需要が抑制されること、また、電力不足や建設コストの高騰、建築の遅延などによってデータセンターへの投資が後ずれする可能性などに注意が必要です。

ただし、AI投資自体は続くとみられることから、ネガティブなニュースに反応して株価が下落する局面などは、**良い投資機会につながる**と考えています。

2027年は、半導体メモリの生産量が増えることで、メモリの価格がやや低下するリスクがあります。しかし、**旺盛なAI需要が継続するとみられることや、自動運転技術の進展、フィジカルAI*1の本格始動**などにより、**中長期的に半導体市場全体が底上げされる可能性**も期待できます。

<半導体市場に影響を及ぼすと考えられる主な要因など>

プラスの影響

マイナスの影響

2025年

2026年

2027年

2028年

世界最大級の半導体企業、エヌビディアが新たな高性能AI向け半導体をローンチ

政府の補助金や「Windows 10」のサポート終了に伴うPCなどの買い替え需要が拡大

世界最大級の半導体受託製造企業、TSMCが最先端半導体2nm*2プロセス「N2」の量産を開始

TSMCが「N2」の生産加速と次世代版「A16」の量産をめざす

「iPhone 18」シリーズに2nmプロセス半導体が搭載される見込み

ロボタクシーや自動運転関連の半導体需要が拡大する見込み

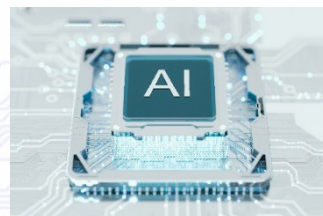
半導体メモリ価格の高騰などでPCやスマホの需要減少が懸念される

半導体メモリメーカーの設備投資拡大により、メモリの供給量が増加見込み

半導体の微細化が技術的な過渡期に入ることや、メモリ価格の下落などから、シリコンサイクルが後退期に入る可能性

旺盛なAI需要や、自動運転、フィジカルAI技術の進展に伴う高い半導体需要は継続する見込み

TSMCが1.4nmプロセス半導体の量産を開始見込み



(資料作成時点)

*1 現実世界の情報をセンサーなどで認識し、状況に応じて自律的に行動できるAI。詳細は4ページをご参照。

*2 ナノメートル(10億分の1メートル)。半導体製造プロセスの世代を示す指標で、数値が小さいほど微細な加工技術を意味する。

※ 写真、イラストはイメージです。

各社の発表や報道などをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※ 記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

AIの進化は次なるフェーズへ 全半導体の需要が拡大し、市場全体の底上げにつながる可能性

過去10年、AIはデジタル世界で大きな進展を遂げましたが、**AIの進化は新たな領域へと移行しつつあり**、**今後は自動運転やロボットといった、リアルの世界が進化の主戦場になるとみられます**。



エンボディド(身体性を持つ)AIとも呼ばれ、現実世界の情報をセンサーなどで認識し、状況に応じた判断を行ない、モーターなどを動かして自律的に動作する。製造業の自動化や自動運転、サービスロボットなど、幅広い分野での実用化が進展しており、AIの次世代応用の本命とも言われる。

デジタル世界のAI

AIは既に企業のインフラとして必要不可欠な存在に

生成AIやエージェントAIといった、**デジタル上で動作するこれまでのAI**についても、**今後の成長余地は大きい**と考えられます。

AIは今や、企業の重要なインフラになりつつあります。既にビジネスに組み込まれたAIは生産性や競争力の面で必要不可欠な役割を担って



おり、**企業はAIに対して今後も継続的に投資を行なうとみられることから、堅調な市場成長が予想されています**。

リアル世界のAI

フィジカルAIが2026年より本格的に始動する見込み

2026年以降、AIはデータ(文章、画像、動画)の作成から、現実世界でモノを動かす(ロボット、自動車など)時代に入るとされています。

この新たなフェーズでは、膨大な量のデータを、同時かつ継続的に分析する必要があることから、**これまで以上にデータセンターの重要性が高まります**。

また、フィジカルAIでは、データセンターやAI向けの先端半導体のみならず、ロボットなどに必要なセンサーやアナログ・パワー半導体など、**あらゆる半導体の需要が拡大すると見込まれ、市場全体の底上げにつながると期待されます**。

<AIのフェーズと必要なデータの処理量>

AIのフェーズ	データ量
1次元:文章	数KB(千バイト)
2次元:画像	数百KB～数MB(メガバイト)
3次元:動画 (1秒間に2次元画像×30枚)	数百MB～数GB(ギガバイト)
4次元:動作 (3次元空間×時間×環境 (温度・湿度・重力・摩擦・・・))	(自動運転の例) 【低速運転】2TB(テラバイト) 【高速運転】767TB

約1,000倍

約1,000倍

桁違いに
拡大

アモーヴァ・アセットマネジメントが作成
※写真、イラストはイメージです。

<フィジカルAIで必要とされる半導体の例>



※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

高市政権は科学技術分野への投資強化を打ち出しており、半導体産業への追い風は続く見込み

2026年の年頭の記者会見において、高市首相は「半導体大国 日本」の復活や、国家的プロジェクトである「ラピダス」に言及したほか、フィジカルAIで世界に打って出ると宣言しました。

政府によるAI・半導体関連支援は近年大きく拡大しており、2026年度当初予算(本予算)案では、前年度当初予算の3.7倍もの額が計上されました。この背景には、これまで政府は主に補正予算で半導体分野への巨額支援を手当てしてきましたが、2026年度以降は毎年1兆円規模を当初予算で確保し、安定的・継続的に資金支援する方針へ転換したことがあります。これにより、**中長期的な支援の予見可能性が高まり、民間投資も呼び込みやすくなる**と期待されています。

また、政府は**科学技術分野への投資強化**を打ち出しており、経済安全保障上の観点から特に重要な技術となる「国家戦略技術」の創設を計画しています。AIや半導体などの6分野が同技術に指定される見込みであり、集中的な政府支援を受けることにより、日本の半導体産業には、さらなる成長が期待されています。

<半導体・AI関連予算の推移>

年度	予算規模
2021年度 補正予算	約7,740億円
2022年度 補正予算	約1兆3,036億円
2023年度 補正予算	約1兆9,867億円*
2024年度 補正予算	約1兆5,228億円
2025年度 補正予算	約3,000億円
2026年度 当初予算案	約1兆2,390億円

*既存基金の残金を含む
経済産業省の資料をもとにアモーヴァ・アセット
マネジメントが作成

<日本のAIに関する政策支援の例>

人工知能基本計画(25年)

国家AI戦略の基本計画。日本の強みを活かし、信頼性の高いAIの開発をめざす。高市首相はAI関連施策に1兆円超の予算投入を表明。







AIロボティクス戦略(25年度内予定)

需給両面から多用途ロボットの開発を推進。AIロボティクスの社会実装を通じ、人口減少に伴う社会課題の解決に繋げる。

「国家戦略技術」の創設(25年度内予定)

先端技術6分野を国家戦略技術に指定し、重点的な優遇措置を講じる。

<「国家戦略技術」6分野の概要>

 AI・先端ロボット 機械学習のプログラムや基幹技術など	 量子 量子コンピューター、量子暗号通信など	 半導体・通信 先端半導体や光電融合技術など
 バイオ・ヘルスケア 医薬品候補物質の探索、新品種開発など	 核融合 核融合発電による新産業の創出など	 宇宙 衛星測位システム、衛星通信など

内閣府の資料や各種報道などをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※ 記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予定であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

AI技術の進展や工場建設の増加 などから恩恵を受ける企業に注目

AI技術の進展に伴ない、AIに不可欠な**先端半導体を生産するための製造装置や材料企業**が恩恵を受けるとみられます。なかでも、今後、**半導体の性能向上を担う後工程において高い競争力を持つ企業**は、世界の半導体企業に製品を提供していることから、どの半導体企業が勝者となってもその恩恵を享受することができます。そうした意味で、現在の**日本企業は有利な立ち位置に付いている**と考えられます。

また、フィジカルAI分野では、現在、自動運転車や産業用・人型ロボットの開発が世界中で加速しています。こうした中、**センサーやパワー半導体などのメーカー**が恩恵を受けると考えられます。

このほか、TSMCの日本子会社、JASMの第2工場やラピダスの第2棟をはじめ、今後も全国で多くの半導体工場の建設が進むとみられることから、引き続き建設関連の需給は逼迫する見込みです。そのため、**先端半導体工場の建設に強みを持つ企業や、電気設備や空調管理などのサブコン*企業**などが注目されます。

なお、半導体の製造工程は多岐にわたる上、ニッチな材料も使用することから、**中小型企業でもグローバルに活躍できるチャンス**があります。

* サブコントラクターの略で、ゼネコンから電気設備や空調設備などの工事を請け負う企業。

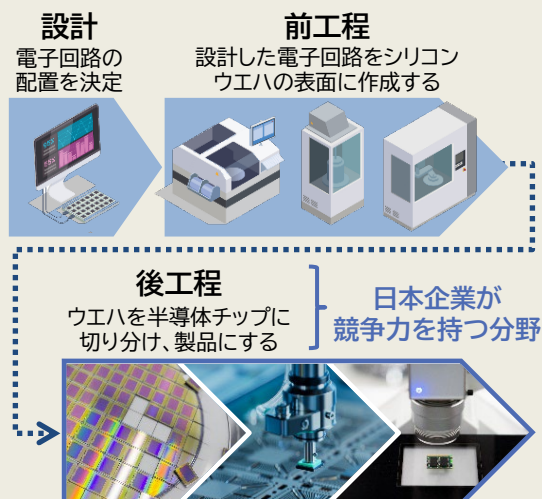
<当ファンドの投資対象となる3つのカテゴリー>

カテゴリー Ⅰ	半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業
カテゴリー Ⅱ	半導体の製造にかかわる企業
カテゴリー Ⅲ	半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺企業

※投資カテゴリーはアモヴァ・アセットマネジメントが考える分類です。

※当ファンドの投資カテゴリーは上記に限定されるものではなく、将来、変更となる可能性があります。

<半導体の製造工程(イメージ)>



対中動向については引き続き注意深く見ていく

中国は国を挙げて半導体産業の育成を進めており、日本企業が得意とする半導体製造装置や材料の分野においても競争環境は厳しさを増しています。しかし、**先端半導体分野では未だ日中の技術差は大きく**、今後、中国で先端半導体に対する設備投資が増える中で、**日本企業はしっかりと恩恵を享受できると**みています。

なお、中期的には、中国向けのウェイトが高い企業や、レガシー半導体(旧世代の製造技術で作られる半導体)向け材料分野などではマイナスの影響を受ける可能性があることから、注意深く見ていく必要があります。

中国当局によるレアアースの輸出規制に関しては、ごく間接的な影響(例えばロボットのモーターに使用する磁石など)が生じる可能性はあるものの、直接の影響はほとんどないと考えられます。今後の動向などについて、注視していきます。

※ 写真、イラストはイメージです。

※ 記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

アドバンテスト

<投資カテゴリー>

半導体製造装置・半導体材料企業

会社概要

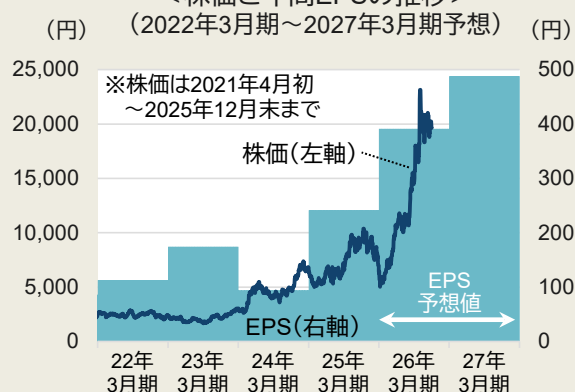
半導体検査装置の世界大手。世界最高水準の製品とソリューションの組み合わせにより、多種多様な半導体や幅広い顧客ニーズに対応。

運用者の注目点

半導体が更に複雑化・高価格化していく中で、半導体が正確に動作するかをテストする需要は高まり続けています。また、フィジカルAIの本格化に伴ない、スマホやPCに比べ、半導体の不具合による影響度が高い製品が今後普及していくと見込まれることも、半導体のテスト需要の拡大要因と考えられます。

<株価と年間EPSの推移>

(2022年3月期～2027年3月期予想)



荏原製作所

<投資カテゴリー>

半導体製造装置・半導体材料企業

会社概要

ポンプを主力に、コンプレッサ・タービン、冷熱機械、送風機、環境プラント、半導体関連装置など、多岐にわたる産業機械を扱う。

運用者の注目点

半導体チップの3D積層における新たな配線接合技術、W2W(ワイヤ・トゥ・ワイヤ)において、同社のCMP装置(ワイヤを研磨する装置)は重要な役割を果たします。W2Wの技術が本格化するの2027年頃とみられており、同社に対する評価もこうした中長期的な技術変化の過程で高まると期待されます。

<株価と年間EPSの推移>

(2021年12月期～2026年12月期予想)



富士紡ホールディングス

<投資カテゴリー>

半導体製造装置・半導体材料企業

会社概要

紡績業を祖業とし、現在は研磨材、化学工業品、生活衣料、化成品の4つの事業領域において、高付加価値な製品の開発・製造に取り組む。

運用者の注目点

「ニッチナンバーワン」をめざす同社は半導体関連分野である研磨剤事業において高い競争力を有しています。CMPの工程で使用される研磨用ソフトパッド分野で同社の世界シェアは約9割(2026年1月時点における同社発表値)に達しており、今後、中工程や後工程においてCMPの活用範囲が広がる中で、その恩恵の拡大が期待されます。

<株価と年間EPSの推移>

(2022年3月期～2027年3月期予想)



信頼できると判断したデータなどをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※ EPS(一株当たり利益)予想値は2026年1月時点の市場予想です。

※ 投資カテゴリーはアモーヴァ・アセットマネジメントが考える分類です。当ファンドの投資カテゴリーは上記に限定されるものではなく、将来、変更となる可能性があります。

上記は、マザーファンドの運用者の見解や公開情報など信用できると判断した情報をもとに、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成しています。記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

<市場別構成比率>

市場	比率
プライム	98.0%
スタンダード	2.0%
グロース	0.0%
その他	0.0%

<規模別構成比率>

時価総額	比率
1兆円以上	53.2%
5,000億円以上1兆円未満	8.6%
2,000億円以上5,000億円未満	24.8%
2,000億円未満	13.4%

<業種別構成比率上位>

業 種	比率
電気機器	36.2%
機械	19.1%
化学	15.9%
建設業	8.9%
卸売業	6.6%
繊維製品	3.2%
その他製品	2.7%
ガラス・土石製品	2.3%
非鉄金属	1.0%
精密機器	0.8%

<投資カテゴリー別構成比率>

投資カテゴリー	比率
半導体製造装置・半導体材料企業	76.4%
半導体の製造にかかわる企業	12.6%
恩恵を受ける周辺企業	11.0%

<組入上位10銘柄>（銘柄数:52銘柄）

	銘柄名	業種	投資カテゴリー	比率
1	アドバンテスト	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	4.84%
2	東京エレクトロン	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	4.71%
3	イビデン	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	4.21%
4	鹿島建設	建設業	恩恵を受ける周辺企業	3.60%
5	扶桑化学工業	化学	半導体製造装置・半導体材料企業	3.36%
6	SCREENホールディングス	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	3.29%
7	荏原製作所	機械	半導体製造装置・半導体材料企業	3.24%
8	富士紡ホールディングス	繊維製品	半導体製造装置・半導体材料企業	3.16%
9	長瀬産業	卸売業	半導体製造装置・半導体材料企業	2.92%
10	関電工	建設業	恩恵を受ける周辺企業	2.88%

※ 上記はマザーファンドの状況です。

※ 「市場別構成比率」「規模別構成比率」「投資カテゴリー別構成比率」は、組入銘柄の評価額の合計を100%として計算したものです。

※ 「業種別構成比率上位」「組入上位10銘柄」は、純資産総額比です。

※ 個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。また、上記銘柄について、将来の組入れを保証するものではありません。

※ 投資カテゴリーはアモーヴァ・アセットマネジメントが考える分類です。当ファンドの投資カテゴリーは上記に限定されるものではなく、将来、変更となる可能性があります。

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

ファンドの特色

1

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている半導体関連企業の株式に投資を行ないます。

2

日本株式の調査・運用に精通したアモーヴァ・アセットマネジメントが運用を行ないます。

3

年1回、決算を行ないます。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

【お申込みに際しての留意事項】

リスク情報

投資者の皆様は投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様へ帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様へ「ジャパン半導体株式ファンド」へのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
 - 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
 - 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
 - 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
 - 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様へ帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡しますので、内容を必ずご確認くださいの上、お客様ご自身でご判断ください。
- ※ 当資料に示す各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

【お申込みメモ】

商品分類	追加型投信／国内／株式
購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額
信託期間	無期限(2023年12月22日設定)
決算日	毎年12月20日(休業日の場合は翌営業日)
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

【手数料等の概要】

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

<申込時、換金時にご負担いただく費用>

購入時手数料	購入時の基準価額に対し <u>3.3%(税抜3%)以内</u> ※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。

<信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>

運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対し <u>年率1.584%(税抜1.44%)</u>
その他の費用・ 手数料	目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用、運用において利用する指数の標章使用料などについては、 <u>ファンドの 日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が 信託財産から支払われます。</u> 組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息および 立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはでき ません。また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はか かりません。

※ 投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて
異なりますので、表示することができません。

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【委託会社、その他関係法人】

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号 加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
販売会社	販売会社については下記にお問い合わせください。 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 [ホームページ]www.amova-am.com [コールセンター]0120-25-1404(午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。)

【投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは】

金融商品取引業者等の名称		登録番号	加入協会			
			日本証券業協会	顧問業協会 一般社団法人 日本投資	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 金融商品 取引業協会
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第67号	○	○	○	
朝日信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第143号	○			
足利小山信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第217号				
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第15号	○	○	○	
株式会社愛媛銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第6号	○			
大垣西濃信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第29号				
岐阜信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第35号	○			
呉信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第25号				
桑名三重信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第37号				
三条信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第244号				
大山日ノ丸証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第5号	○			
高松信用金庫	登録金融機関	四国財務局長(登金)第20号				
知多信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第48号				
株式会社千葉興業銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第40号	○			
東武証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第120号	○			
富山信用金庫	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第27号				
豊川信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第54号				
長野信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第256号	○			
奈良信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第71号	○			
西尾信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第58号	○			
沼津信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第59号				
浜松磐田信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第61号				
平塚信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第196号				
福井信用金庫	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第32号				
福岡ひびき信用金庫	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第24号	○			
丸八証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第20号	○			
株式会社三菱UFJ銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
水戸信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第227号				
明和證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第185号	○			
めぶき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第1771号	○			

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

(50音順、2026年1月20日現在)